



Karta przedmiotu

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|-------|
| Nazwa i kod przedmiotu | Niezawodność i diagnostyka, PG_00048306 | | | | | | |
| Kierunek studiów | Elektronika i telekomunikacja | | | | | | |
| Data rozpoczęcia studiów | luty 2024 r. | | Rok akademicki realizacji przedmiotu | | 2024/2025 | | |
| Poziom kształcenia | II stopnia | | Grupa zajęć | | Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki | | |
| Forma studiów | stacjonarne | | Sposób realizacji | | na uczelni | | |
| Rok studiów | 2 | | Język wykładowy | | polski | | |
| Semestr studiów | 3 | | Liczba punktów ECTS | | 2.0 | | |
| Profil kształcenia | ogólnoakademicki | | Forma zaliczenia | | egzamin | | |
| Jednostka prowadząca | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki | | | | | | |
| Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców) | Odpowiedzialny za przedmiot | | dr hab. inż. Paweł Wierzba | | | | |
| | Prowadzący zajęcia z przedmiotu | | dr hab. inż. Paweł Wierzba | | | | |
| Formy zajęć i metody nauczania | Forma zajęć | Wykład | Ćwiczenia | Laboratorium | Projekt | Seminarium | RAZEM |
| | Liczba godzin zajęć | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
| | W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 | | | | | | |
| Aktywność studenta i liczba godzin pracy | Aktywność studenta | Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów | | Udział w konsultacjach | | Praca własna studenta | RAZEM |
| | Liczba godzin pracy studenta | 30 | | 2.0 | | 18.0 | 50 |
| Cel przedmiotu | Celem jest wprowadzenie do: statystycznej teorii niezawodności, planowania badań niezawodnościowych, metod testowania układów elektronicznych metodami elektrycznymi, optycznymi, rentgenowskimi oraz ich diagnostyki metodami słownikowymi z klasyfikatorem neuronowym. | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Efekty uczenia się przedmiotu | Efekt kierunkowy | Efekt z przedmiotu | Sposób weryfikacji i oceny efektu |
| | [K7_U09] potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania, a także wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem zaawansowanych urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla kierunku studiów | Posługuje się statystyczną teorią niezawodności. Posługuje się normami w zakresie niezawodności. Konstruuje słownik uszkodzeń do lokalizacji uszkodzeń w układzie elektronicznym. Bada i analizuje działanie klasyfikatora neuronowego w zastosowaniu do lokalizacji uszkodzeń w analogowym układzie elektronicznym. | [SU4] Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi |
| | [K7_U06] potrafi analizować działanie elementów, układów i systemów związanych z kierunkiem studiów oraz mierzyć ich parametry i badać charakterystyki techniczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski | Montuje i bada układ pomiarowy realizujący wtórnikową metodę wyizolowywania testowanego elementu z otaczającej go sieci elektrycznej. | [SU1] Ocena realizacji zadania |
| | [K7_W08] zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla kierunku kształcenia | Docenia znaczenie testowania w utrzymaniu jakości wyrobów. | [SW1] Ocena wiedzy faktograficznej |
| | [K7_W06] zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych | Wyjaśnia znaczenie terminów: defekt, uszkodzenie, poziomy diagnostyki: detekcja, lokalizacja, identyfikacja, predykcja uszkodzeń. Klasyfikuje uszkodzenia obiektów technicznych. | [SW1] Ocena wiedzy faktograficznej |
| [K7_W03] zna i rozumie w pogłębionym stopniu budowę i zasady działania komponentów i systemów związanych z kierunkiem studiów, w tym teorie, metody i złożone zależności między nimi oraz wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla programu kształcenia | Wymienia i opisuje metody testowania gołych i zabudowanych elementami płytek z obwodami drukowanymi. Zna budowę wewnątrzobwodowych testerów pakietów elektronicznych. Zna metody wirtualnego rozwierania obwodów testowanych. | [SW1] Ocena wiedzy faktograficznej | |
| Treści przedmiotu | 1. Statystyczna teoria niezawodności. Podstawowe charakterystyki niezawodności. Fizyka uszkodzeń. Rodzaje obiektów. Rodzaje uszkodzeń. 2. Źródła danych o niezawodności. Metody gromadzenia danych o niezawodności. Jakość i niezawodność elementów i systemów w pełnym cyklu życia – projekt, technologia, eksploatacja, uszkodzenie. 3. Zasady wnioskowania o rozkładach uszkodzeń: Rozkłady uszkodzeń: Gaussa, wykładniczy, Weibulla, logarytmiczno-normalny, uogólniony gamma. Metody grafoanalityczne i analityczne. 4. Planowanie badań niezawodnościowych. Badania określające, kontrolne. Skracanie czasu badań. Badania przyspieszone w warunkach forsownych. 5. Rodzaje struktur niezawodnościowych systemów. Metody podwyższania niezawodności. 6. Nadmiary niezawodnościowe obiektów. Zarządzanie oraz sterowanie jakością i niezawodnością. Jakość i niezawodność w przedsiębiorstwach. 7. Szacowanie kosztów cyklu życia. Systemy norm polskich i międzynarodowych. 8. Strategie testowania układów elektronicznych. Testowanie funkcjonalne i strukturalne. Techniki testowania produkcyjnego monolitycznych układów scalonych. 9. Diagnostyka pakietów elektronicznych. Testowanie wewnątrz-obwodowe. Techniki wyizolowywania układów z otaczającej sieci. Metoda analizy sygnatur. 10. Techniki projektowania dla testowania. Magistrale ułatwionego testowania. Magistrala testowania układów, pakietów i systemów cyfrowych IEEE 1149.1 – geneza i architektura; struktura i diagram stanów sterownika TAP. 11. Magistrala mieszana sygnałowo IEEE 1149.4: architektura magistrali, układ interfejsu testowego TBIC, analogowy moduł brzegowy ABM. 12. Wbudowane układy samotestujące. BIST cyfrowy. Struktury BILBO. 13. Słownikowe metody lokalizacji uszkodzeń. Modelowanie i symulacja uszkodzeń w układach elektronicznych na różnych poziomach abstrakcji. Generacja sygnatur uszkodzeń za pomocą transformacji liniowej Karhuen-Loeve. 14. Klasyfikatory neuronowe w diagnostyce. Liniowa funkcja klasyfikująca. Algorytm perceptronu. 15. Bezkontaktowe metody diagnostyki: automatyczna inspekcja optyczna, radiografia, termowizja. | | |
| Wymagania wstępne i dodatkowe | Nie ma wymagań | | |
| Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się | Sposób oceniania (składowe) | Próg zaliczeniowy | Składowa oceny końcowej |
| | Laboratorium | 50.0% | 40.0% |
| | Egzamin pisemny | 50.0% | 60.0% |
| Zalecana lista lektur | Podstawowa lista lektur | 1. Burns M., Roberts G.W.: An introduction to Mixed-Signal IC Test & Measurement. New York: Oxford University Press, 2001. 2. Bushnell M.L., Agrawal V.D.: Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory, and Mixed Signal VLSI Circuits. Kluwer Academic Publishers, 2000. 3. Papoulis A., Pillai S.U.: Probability, Random Variables and Stochastic Processes. Mc Graw Hill 2002. 4. Segura J., Hawkins C.F.: CMOS Electronics how it works, how it fails. IEEE Press, A John Wiley and Sons, Inc. 2004. 5. Sun Y.: Test and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal And RF Integrated Circuits. The System On Chip Approach. IET 2008. | |

| | Uzupełniająca lista lektur | Nie ma wymagań |
|---|--|----------------------------------|
| | Adresy eZasobów | Adresy na platformie eNauczanie: |
| Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjaśnić pojęcia: defekt, uszkodzenie, testowanie prototypu, testowanie produkcyjne, testowanie narażeniowe, diagnostyka. 2. Problemy związane ze stosowaniem pasty lutowniczej w montażu pakietów elektronicznych. 3. Metody testowania "gołych" płytek z obwodami drukowanymi. 4. Rodzaje defektów występujących na pakietach elektronicznych zabudowanych elementami (20 rodzajów defektów). 5. Metody testowania pakietów elektronicznych zabudowanych elementami. 6. Zasady stosowane w wewnątrzobwodowym testowaniu pakietów elektronicznych. 7. Typy sond ostrzowych stosowanych w testerach pakietów z głowicami typu "bed-of- nails". 8. Zalety i wady testerów typu "flying probe". 9. Omówić technologię "Bead probes". 10. Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego do wewnątrzobwodowego pomiaru rezystancji. 11. Zasada działania wtórnikowej metody wyizolowywania mierzonych elementów z otaczającej sieci elektrycznej. 12. Koncepcja słownikowej metody diagnostycznej. 13. Wymienić i scharakteryzować techniki ekstrakcji cech diagnostycznych z sygnału pomiarowego. 14. Jakie efekty uzyskuje się stosując analizę składowych głównych do ekstrakcji cech diagnostycznych. 15. Metryki używane w klasyfikatorach geometrycznych. 16. Dla klasyfikatora liniowego wyprowadzić wzór na odległość linii decyzyjnej od środka układu współrzędnych przestrzeni cech. 17. Dla klasyfikatora liniowego wyprowadzić wzór pozwalający obliczyć odległość dowolnego punktu w przestrzeni cech od linii decyzyjnej. 18. Dla klasyfikatora liniowego napisać równanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej i obliczyć współrzędne punktów przecięcia linii decyzyjnej z osiami x_1 i x_2 dla wektora wag \mathbf{w} i b. Obliczyć odległość linii decyzyjnej od środka układu współrzędnych. 19. Narysować schemat blokowy układu scalonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149.1 i wyjaśnić zasadę pracy. 20. Wymienić i opisać sygnały magistrali IEEE 1149.1. 21. Wymienić podstawowe stany sterownika TAP oraz opisać pracę rejestru instrukcji w magistrali IEEE 1149.1. 22. Wymienić i scharakteryzować obowiązkowe instrukcje magistrali IEEE 1149.1. 23. Naskicować krzywą "wannową" i opisać trzy etapy życia produktu 24. Jakie rozkłady prawdopodobieństwa są wykorzystywane do opisu danych niezawodnościowych. 25. Dany jest system składający się z trzech urządzeń połączonych równolegle. Wartości niezawodności poszczególnych urządzeń wynoszą odpowiednio R_1, R_2 i R_3 dla czasu pracy 1000 godzin. Jaka jest niezawodność całego systemu dla czasu pracy 1000 godzin? | |

